

# 2020-2026年中国集成电路 封装行业前景展望与投资战略研究报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2020-2026年中国集成电路封装行业前景展望与投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202005/162976.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第1章：中国集成电路封装行业发展背景

1.1 集成电路封装行业定义及分类

1.1.1 集成电路封装界定

- (1) 集成电路封装产业概念
- (2) 集成电路封装产业链位置
- (3) 集成电路封装作用

1.1.2 集成电路封装行业产品分类

- (1) 按功能分类
- (2) 按集成度分类
- (3) 按封装外形分类

1.1.3 集成电路封装行业特性分析

- (1) 行业周期性失灵
- (2) 行业区域性
- (3) 行业季节性

1.2 集成电路封装行业政策环境分析

1.2.1 行业管理体制

1.2.2 行业相关政策

1.3 集成电路封装行业经济环境分析

1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析

- (1) 国际宏观经济现状
- (2) 国际宏观经济展望
- (3) 国际宏观经济环境对行业影响分析

1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析

- (1) 中国GDP及增长情况分析
- (2) 中国工业经济增长分析
- (3) GDP与集成电路封装行业的关联性分析
- (4) 居民收入水平

1.3.3 居民收入与行业的相关性

1.4 集成电路封装行业技术环境分析

- 1.4.1 集成电路封装技术演进分析
- 1.4.2 集成电路封装形式应用领域
- 1.4.3 集成电路封装工艺流程分析
- 1.4.4 集成电路封装行业新技术动态

## 第2章：中国集成电路产业发展分析

### 2.1 集成电路产业发展状况

#### 2.1.1 集成电路产业简介

#### 2.1.2 集成电路产业发展现状

#### 2.1.3 集成电路产业运营情况

#### 2.1.4 集成电路产业三大区域分析

- (1) 集成电路产业分布特征
- (2) 集成电路产业布局发展趋势
- (3) 未来集成电路产业空间布局

#### 2.1.5 集成电路产业面临挑战、发展途径以及发展前景

- (1) 集成电路产业当下存在问题
- (2) 集成电路产业“十三五”面临挑战
- (3) 集成电路产业“十三五”发展途径
- (4) 集成电路产业发展前景

#### 2.1.6 集成电路产业发展预测

- (1) 战略性新兴产业将加速发展
- (2) 资本市场将为企业融资提供更多机会

### 2.2 集成电路设计业发展状况

#### 2.2.1 集成电路设计业发展概况

#### 2.2.2 集成电路设计业行业发展现状

- (1) 产业规模持续扩大
- (2) 产业结构调整加速
- (3) 企业规模加速发展
- (4) 技术能力大幅提升

#### 2.2.3 集成电路设计业行业政策分析

#### 2.2.4 集成电路设计业发展策略分析

#### 2.2.5 集成电路设计业“十三五”发展预测

(1) 产业规模

(2) 企业建设

(3) 技术水平

## 2.3 集成电路制造业发展状况

### 2.3.1 集成电路制造业发展现状分析

(1) 集成电路制造业发展总体概况

(2) 集成电路制造业发展主要特点

### 2.3.2 集成电路制造行业规模及财务指标分析

(1) 集成电路制造行业规模分析

(2) 集成电路制造行业盈利能力分析

(3) 集成电路制造行业运营能力分析

(4) 集成电路制造行业偿债能力分析

(5) 集成电路制造行业发展能力分析

### 2.3.3 集成电路制造行业供需平衡分析

(1) 集成电路制造行业供给情况分析

(2) 集成电路制造行业需求情况分析

(3) 全国集成电路制造行业产销率分析

### 2.3.4 集成电路制造业“十三五”发展预测

## 第3章：中国集成电路封装行业发展分析

### 3.1 中国集成电路封装行业发展历程

### 3.2 中国集成电路封装行业发展现状

#### 3.2.1 集成电路封装行业规模分析

#### 3.2.2 集成电路封装行业发展现状分析

#### 3.2.3 集成电路封装行业利润水平分析

#### 3.2.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

#### 3.2.5 集成电路封装行业影响因素分析

(1) 有利因素

(2) 不利因素

#### 3.2.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测

(1) 发展趋势分析

(2) 前景预测

### 3.3 半导体封测发展情况分析

#### 3.3.1 半导体行业发展概况

#### 3.3.2 半导体行业景气预测

#### 3.3.3 半导体封装发展分析

(1) 封装环节产值逐年成长

(2) 封装环节外包是未来发展趋势

### 3.4 集成电路封装类专利分析

#### 3.4.1 专利分析样本构成

(1) 数据库选择

(2) 检索方式

#### 3.4.2 专利发展情况分析

(1) 专利申请数量趋势

(2) 专利公开数量趋势

(3) 技术分类趋势分布

(4) 主要权利人分布情况

### 3.5 集成电路封装过程部分技术问题探讨

#### 3.5.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策

(1) 封装开裂的影响因素分析

(2) 管控影响开裂的因素的方法分析

#### 3.5.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策

(1) 产生芯片弹坑问题的因素分析

(2) 预防芯片弹坑问题产生的方法

## 第4章：中国集成电路封装市场产品及需求分析

### 4.1 集成电路封装行业主要产品分析

#### 4.1.1 BGA产品市场分析

(1) BGA封装技术

(2) BGA产品主要应用领域

(3) BGA产品需求拉动因素

(4) BGA产品市场应用现状分析

(5) BGA产品市场前景展望

#### 4.1.2 SIP产品市场分析

- (1) SIP封装技术
- (2) SIP产品主要应用领域
- (3) SIP产品需求拉动因素
- (4) SIP产品市场应用现状分析
- (5) SIP产品市场前景展望

#### 4.1.3 SOP产品市场分析

- (1) SOP封装技术
- (2) SOP产品主要应用领域
- (3) SOP产品市场发展现状
- (4) SOP产品市场前景展望

#### 4.1.4 QFP产品市场分析

- (1) QFP封装技术
- (2) QFP产品主要应用领域
- (3) QFP产品市场发展现状
- (4) QFP产品市场前景展望

#### 4.1.5 QFN产品市场分析

- (1) QFN封装技术
- (2) QFN产品主要应用领域
- (3) QFN产品市场发展现状
- (4) QFN产品市场前景展望

#### 4.1.6 MCM产品市场分析

- (1) MCM封装技术水平概况
- (2) MCM产品主要应用领域
- (3) MCM产品需求拉动因素
- (4) MCM产品市场发展现状
- (5) MCM产品市场前景展望

#### 4.1.7 CSP产品市场分析

- (1) CSP封装技术水平概况
- (2) CSP产品主要应用领域
- (3) CSP产品市场发展现状
- (4) CSP产品市场前景展望

#### 4.1.8 其他产品市场分析

(1) 晶圆级封装市场分析

(2) 覆晶/倒封装市场分析

(3) 3D封装市场分析

#### 4.2 集成电路封装行业市场需求分析

##### 4.2.1 计算机领域对行业的需求分析

(1) 计算机市场发展现状

(2) 集成电路在计算机领域的应用

(3) 计算机领域对行业需求的拉动

##### 4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析

(1) 消费电子市场发展现状

(2) 消费电子领域对行业需求的拉动

##### 4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析

(1) 通信设备市场发展现状

(2) 集成电路在通信设备领域的应用

(3) 通信设备领域对行业需求的拉动

##### 4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析

(1) 工控设备市场发展现状

(2) 集成电路在工控设备领域的应用

1) 工业机器人

2) 变频器

3) 传感器

4) 工控机

5) 机器视觉

6) 3D打印

7) 运动控制器

(3) 工控设备领域对行业需求的拉动

##### 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析

(1) 汽车电子市场发展现状

(2) 集成电路在汽车电子领域的应用

(3) 汽车电子领域对行业需求的拉动

##### 4.2.6 医疗电子领域对行业的需求分析

(1) 医疗器械制造业发展情况

(2) 集成电路在医疗电子领域的应用

(3) 医疗电子领域应用前景分析

## 第5章：集成电路封装行业市场竞争分析

### 5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析

#### 5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况

#### 5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析

#### 5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析

(1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本

(2) 主板材料的变化趋势

#### 5.1.4 国际集成电路封装行业扶持措施借鉴

### 5.2 跨国企业在华市场竞争力分析

#### 5.2.1 台湾日月光集团竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业组织构架

(3) 企业运营情况分析

(4) 企业财务情况分析

#### 5.2.2 美国安靠 (Amkor) 公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业主营产品及应用领域

(3) 企业市场区域及行业地位分析

(4) 企业在中国市场投资布局情况

#### 5.2.3 台湾矽品公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

#### 5.2.4 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

## 5.2.5 力成科技股份有限公司竞争力分析

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业主营产品及应用领域
- (4) 企业市场区域及行业地位分析

## 5.2.6 飞思卡尔公司竞争力分析

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业主营产品及应用领域
- (3) 企业市场区域及行业地位分析
- (4) 企业在中国市场投资布局情况

## 5.2.7 英飞凌科技公司竞争力分析

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业主营产品及应用领域
- (3) 企业市场区域及行业地位分析
- (4) 企业在中国市场投资布局情况

## 5.3 集成电路封装行业国内竞争格局分析

### 5.3.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析

### 5.3.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析

## 5.4 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

### 5.4.1 现有竞争者之间的竞争

### 5.4.2 上游议价能力分析

### 5.4.3 下游议价能力分析

### 5.4.4 行业潜在进入者分析

### 5.4.5 替代品风险分析

### 5.4.6 行业竞争五力模型总结

## 第6章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析

### 6.1 集成电路封装企业发展总体状况分析

### 6.2 集成电路封装行业领先企业个案分析

#### 6.2.1 上海华岭集成电路技术股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

(3) 企业运营业务情况分析

(4) 企业技术及资质发展情况

#### 6.2.2 山东齐芯微系统科技股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业股权结构分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业产品结构分析

#### 6.2.3 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业股权结构分析

(3) 企业发展商业模式分析

(4) 企业发展面临风险情况分析

#### 6.2.4 南通华隆微电子股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业股权结构情况

(3) 企业商业模式分析

(4) 企业发展面临风险情况分析

#### 6.2.5 上海芯哲微电子科技股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

#### 6.2.6 深圳电通纬创微电子股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

#### 6.2.7 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

#### 6.2.8 苏州晶方半导体科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

#### 6.2.9 天水华天科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

#### 6.2.10 南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

#### 6.2.11 苏州固锝电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业组织架构分析
- (4) 企业产品结构及新产品动向

#### 6.2.12 星科金朋（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析

#### 6.2.13 大唐微电子技术有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络

#### 6.2.14 矽品科技（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络

#### 6.2.15 安靠封装测试（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络

### 第7章：中国集成电路封装行业投资分析及建议

#### 7.1 集成电路封装行业投资特性分析

##### 7.1.1 集成电路封装行业进入壁垒

- (1) 技术壁垒
- (2) 渠道壁垒
- (3) 人才壁垒
- (4) 市场规模壁垒
- (5) 出口资质壁垒

##### 7.1.2 集成电路封装行业盈利模式

##### 7.1.3 集成电路封装行业盈利因素

#### 7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

##### 7.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

##### 7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

##### 7.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

- (1) 通富微电公司投资兼并与重组分析
- (2) 华天科技公司投资兼并与重组分析
- (3) 长电科技公司投资兼并与重组分析

##### 7.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

#### 7.3 集成电路封装行业投融资分析

##### 7.3.1 产业基金对集成电路产业的扶持分析

- (1) 基金对集成电路产业的扶持情况
- (2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议
- (3) 大基金对集成电路产业的投资情况

(4) 大基金对集成电路产业的投资建议

7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析

7.3.3 半导体行业资本支出分析

7.4 集成电路封装行业投资建议

7.4.1 集成电路封装行业投资机会分析

7.4.2 集成电路封装行业投资风险分析

7.4.3 集成电路封装行业投资建议

(1) 投资区域建议

(2) 投资产品建议

(3) 技术升级建议

部分图表目录:

图表1：封装在集成电路制造产业链中位置

图表2：集成电路封装行业产品分类

图表3：集成电路封装行业产品分类

图表4：集成电路封装产品按封装外形分类

图表5：2020-2026年江苏长电科技股份有限公司季度销售收入分布（单位：万元）

图表6：集成电路封装行业主要政策分析

图表7：2018-2024年中国国内生产总值情况及增长率（单位：亿元，%）

图表8：2018-2024年我国全部工业增加值增速（单位：亿元，%）

更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202005/162976.html>